

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

半導體及太陽能設備業務發展的進展

本公告由普達特科技有限公司*(「本公司」)自願作出，以向本公司股東及有意投資者提供有關本公司最新業務發展的資料。

茲提述本公司日期為二零二三年八月十日的公告(「該公告」)，內容有關半導體及太陽能設備業務的發展情況。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

鏈式銅電鍍設備INCELLPLATE Cu系列採購訂單簽訂

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月二十二日本公司與客戶簽訂鏈式銅電鍍設備Incellplate Cu系列(「該設備」)採購訂單。該採購訂單的收入暫未確認。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，該客戶及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

銅電鍍技術可用於N型太陽能電池片技術路線(細分為TOPCon、HJT及IBC)。銅電鍍技術使用低成本金屬作為金屬化互聯材料替代貴金屬銀，可以有效降低生產成本。相較於傳統絲網印刷技術，銅電鍍技術預計可實現人民幣0.02元/瓦特至0.04元/瓦特的成本降低。

銅金屬化電極具有更小的金屬線電阻 $1.7\Omega\cdot m$ ，導電性較佳。更細的銅柵線可使銅電鍍的遮光損失相對較小。此外，電鍍銅電極內部緻密且均勻，可有效降低電極的歐姆損耗。因此銅電鍍技術相較於傳統技術可實現0.3%至0.5%的電池轉化效率提升。

Incellplate Cu系列設備基於多功能鏈式電鍍工藝開發，採用垂直式電鍍、水平鏈式電鍍及插片式電鍍三種主流技術路線中的水平鏈式電鍍路線，因其具有兩大顯著優勢：

- 1) 水平鏈式電鍍路線適應大範圍尺寸，可實現全自動操作，因此產能相對較高；及
- 2) 水平鏈式電鍍路線可使電池表面接觸溶液均勻，可保證電鍍層的均勻性和電池片的穩定性。

Incellplate Cu系列設備可以兼容不同種類的金屬電鍍工藝和不同種類電池結構，在電池片傳輸電能過程中提供穩定可靠的電流供給和分配方案，形成設備、材料、工藝、廢液回收利用完整工藝解決方案。

該設備為太陽能電池片製造金屬化工藝設備，利用電解原理在特定金屬表面電鍍其他金屬或合金層，用於實現太陽能電池片的電極成型。

一般事項

採購訂單項下擬進行的交易並無構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下本公司的須予公佈交易。本公司將適時另行刊發公告(如需)。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二三年八月二十二日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士(主席)、譚嶠先生及劉知海先生；一名為非執行董事，即曹霄輝先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、周承炎先生及王國平先生。

* 僅供識別